

テーマ番号 (M5 2 0) : マイクロジョイントの研究 {(株) フジクラ}

主要論文

- 1) Akinobu Satoh;” Mechanism and Characteristics of Through-hole Formation on Si Wafer by Optical Excitation Electropolishing Method” , Jpn. J. App. Phys. Vol. 39, No.4A, (2000) pp.1612~1621.
- 2) Akinobu Satoh; “Formation of Through-hole on Silikon Wafer by optical Excitation Electropolishing Method” , Jpn. J. Appl. Physy. Vol. 39, No. 2A, (2000) pp.378~386.
- 3) Akinobu Satoh; “Water Glass Bonding” , Sensors and Actuators(A),Vol. 72, (1999)pp.160~168.
- 4) 佐藤倬暢、鈴木孝直、橋本広和; “セルフパッケージ型マイクロ赤外線センサ”、電気学会論文誌、Vol. 118-E、No.9、(1998) pp.393~400.
- 5) Akinobu Satoh; “Through-hole Interconnections Formed by Optical Excitation Electropolishing Method” , Trans. IEE of Japan, Vol. 120-E, No. 12, (2000) pp.565~575.
- 6) Akinobu Satoh; “Application of Block Technology for the Self-Packaging” , Proc. the Third international micromachine symposium, (1997.10)pp.163~169.
- 7) Akinobu Satoh, Tatu Suemasu and Yukio Suga; “Wafer Level Three-Dimensional Integration Technology” , Proc. of 2nd International Workshop on Microfactories, Fribourg (Switzerland), (2000.10) pp.123~127.
- 8) A. Satoh, K. Itoi, S. Kageyama, Y. Suga and T. Suemasu; “Wafer Level Three-Dimensional Integration Technology” , Proc. of The sixth International Micromachine Symposium, (2000.11) pp.179~185.

主要特許

- 1) 佐藤倬暢、橋本幹夫、紫外線検知装置の製造方法、第 2860027 ; 1998/10/04
- 2) 佐藤倬暢、鈴木孝直、微小連結装置およびその製造方法、第 2878537 ; 1999/04/05
- 3) 佐藤倬暢、稲葉正俊、紫外線検知装置及びその製造方法、第 2860028 ; 1998/12/04
- 4) 橋本広和、鈴木孝直、赤外線センサ及びその製造方法、平成 6 年第 327240、1994/12/28
- 5) 稲葉正俊、圧力センサ装置、平成 9 年第 34022、1997/02/18
- 6) 糸井和久、光励起電解研磨法による貫通孔形成方法、特願 2001-12502、2001/01/19
- 7) 末益龍夫、微細空間への金属充填装置及び金属充填方法、特願 2000-355725、2000/11/22